

TPS53832 DDR5 DIMM 電源向け統合型降圧デジタル・コンバータ

1 特長

- シングル・チップで DDR5 アプリケーションをサポート
- VDD (1.1V)、VDDQ (1.1V)、VPP (1.8V) を供給する 3 つの出力と任意の第 4 の出力 (VDD2)
- 3 出力の場合、VDD (SWA 2 相) に 7A、VDDQ (SWC) に 3.5A、VPP (SWD) に 3.5A
- 4 出力の場合、VDD1 (SWA) に 3.5A、VDD2 (SWB) に 3.5A、VDDQ (SWC) に 3.5A、VPP (SWD) に 3.5A
- 差動リモート・センシング: VDD、VDDQ、VPP
- D-CAP+™ 制御による高速過渡応答
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~15V
- プログラム可能な内部ループ補償
- サイクル単位の各相電流制限
- 周波数をプログラム可能: 500kHz~1.375MHz
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定のための I²C および I³C バス・インターフェイスをサポート
- 過電流、過電圧、過熱保護
- 不揮発性レジスタ (ブラック・ボックス) 機能
- 低静止電流
- 5mm × 5mm の 35 ピン QFN PowerPad™ パッケージ

2 アプリケーション

- サーバー用 DDR5 DIMM 電源

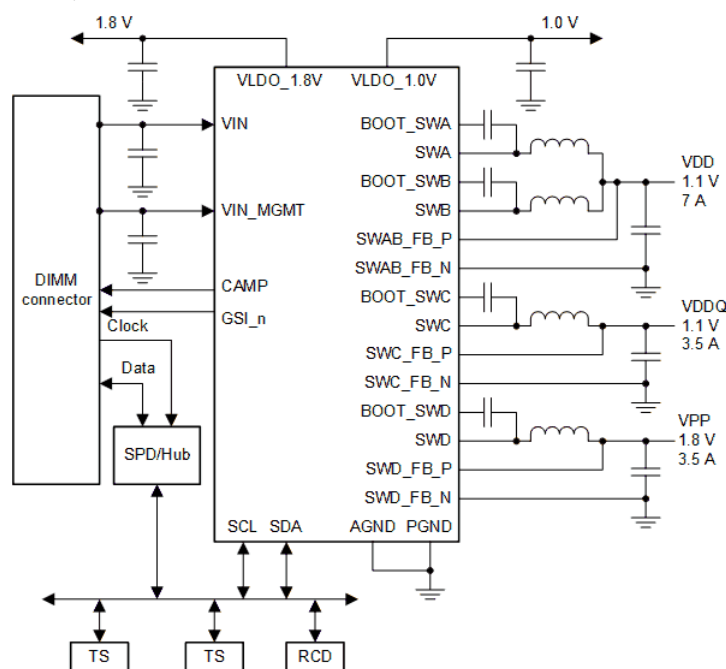


図 3-1. アプリケーション概略

3 概要

TPS53832 は、DDR5 DIMM 電源用 D-CAP+™ モード統合型降圧コンバータです。本デバイスは、設定可能な電流能力で DIMM モジュールの DRAM チップに VDD、VDDQ、VPP 電圧を供給します。大電流レールを 2 相または 2 出力に構成し、D-CAP+™ モード制御で最大 7A (または 3.5A + 3.5A) の電流を供給できます。また、内部補償機能を備えているため使いやすく、外付け部品数も減らせます。

本コンバータは入力電圧、出力電圧、出力電流などの遠隔測定機能を備えています。過電圧、低電圧、過電流制限、過熱保護機能も備えています。

TPS53832 は放熱特性に優れた 35 ピンの QFN パッケージで供給され、-40°C~+125°Cで動作します。

製品情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	本体サイズ (公称)
TPS53832	RWZ	5.00mm × 5.00mm

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。



4 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

DATE	REVISION	NOTES
September 2021	*	Initial release.

5 Device and Documentation Support

5.1 Receiving Notification of Documentation Updates

To receive notification of documentation updates, navigate to the device product folder on [ti.com](https://www.ti.com). Click on *Subscribe to updates* to register and receive a weekly digest of any product information that has changed. For change details, review the revision history included in any revised document.

5.2 サポート・リソース

[TI E2E™ サポート・フォーラム](#)は、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の[使用条件](#)を参照してください。

5.3 Trademarks

D-CAP+™, PowerPad™, TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.4 Electrostatic Discharge Caution



This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.



5.5 Glossary

[TI Glossary](#) This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
TPS53832RWZR	ACTIVE	VQFN-HR	RWZ	35	3000	RoHS & Green	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	TPS 53832	
TPS53832RWZT	ACTIVE	VQFN-HR	RWZ	35	250	RoHS & Green	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 105	TPS 53832	

(1) The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

(3) MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

(4) There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

(5) Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

(6) Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2023, Texas Instruments Incorporated